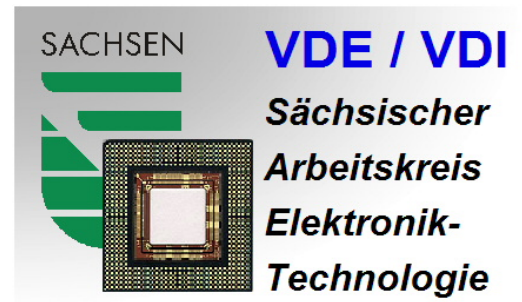


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
01069 Dresden
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
Technische Universität Dresden
Zentrum für mikrotechnische Produktion
01062 Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet: <http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

44. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

am Mittwoch, 29. Juni 2005 10.00 Uhr

bei der KSG Leiterplatten GmbH
Auerbacher Straße 3-5, 09390 Gornsdorf

Veranstaltungsort: Volkshaus Gornsdorf, Am Andreasberg 5 (ca. 500m von KSG entfernt)

Thema: Neue Herausforderungen an die Leiterplattentechnik

Leitung: Herr Dr.-Ing. Bechtloff, GF der KSG Leiterplatten GmbH
Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Fachbereich Elektrotechnik

- 10:00 Uhr **Begrüßung**
Herr Dr. Bechtloff, Herr Prof. Bauer
- 10:15 Uhr **Präsentation der KSG Leiterplatten GmbH**
Herr Dr. Bechtloff, KSG Leiterplatten GmbH
- 10:45 Uhr **Dickkupfer-Technologien in der Leiterplatte**
Herr Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH
- 11:45 Uhr **Integration optischer Layer in die Leiterplatte – Stand und Tendenzen**
Herr Dr. Schmieder, KSG Leiterplatten GmbH
- 12:15 Uhr *Mittagspause*
- 13:00 Uhr **Aktuelle Anforderungen an Leiterplatten aus der Sicht der COB- Technologie**
Herr Schneider, Microelectronic Packaging Dresden GmbH
- 13:30 Uhr **Auswirkung des Designs auf die Herstellungskosten einer Leiterplatte**
Herr Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH
- 14:15 Uhr **Untersuchungen zum plasmagestützten Löten mit bleifreien Loten**
Herr Dr. Herzog, TU Dresden, IAVT || Zusätzliche Info von Linde Gas AG zum Thema
- 14:45Uhr *Fertigungsbesichtigung bei KSG*
- 16:00 Uhr **Abschlussdiskussion**

Alle Interessenten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Um eine rechtzeitige Teilnahmemeldung wird gebeten. Kontaktaufnahme bitte an Herrn Prof. R. Bauer (bauer@et.htw-dresden.de, Tel.: 0351/462 3605, Fax: 0351/462 2175).